**合肥颀中科技股份有限公司**

**2024年度“提质增效重回报”行动方案**

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实关于开展上市公司提质增效重回报专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振和资本市场稳定发展的精神，特制定《合肥颀中科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。相关方案如下：

**一、专注主业经营，提升经营质量与效率**

公司主要从事集成电路的先进封装与测试业务，目前主要聚焦于显示驱动芯片封测领域和以电源管理芯片、射频前端芯片为代表的非显示类芯片封测领域。2023年，公司实现营业收入162,934.00万元，较上年同期增长23.71%；实现归属于上市公司股东的净利润37,166.25万元，较上年同期增长22.59%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润33,968.54万元，较上年同期增长25.29%。2024年，公司将继续聚焦主营业务，坚持“以技术创新为核心驱动力”的研发理念，努力提升核心技术水平，持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力。具体包括以下几个方面：

**1、延伸技术产品线，优化产品结构**

公司在金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装、柔性屏幕覆晶封装、薄膜覆晶封装等主要工艺环节拥有雄厚技术实力，主要技术指标在行业内属于领先水平。与此同时，公司在高端设备技术改造、自动化系统方面具有较强实力，相关技术覆盖了整个生产制程，为公司产品保持较高竞争力提供了坚实保障。近年来，公司在境内显示驱动芯片封测领域常年保持领先地位，在整个封测行业的知名度和影响力不断提升。

公司在显示驱动芯片封测领域，持续深耕，保持行业领先地位。显示驱动芯片一直以金凸块为主流，近年金价日益攀升，制造成本随之升高。公司目前积极投入研究铜镍金凸点工艺取代金凸点工艺，在保证性能满足需求，使显示驱动芯片制造成本降低，实现突破传统材料限制的创新技术，提供多元化的工艺服务。同时，公司还积极研究新型凸点结构，为显示芯片封测工艺的提升和变革超前部署，为客户提供多元化的工艺技术解决方案，提高技术和产品的竞争力。

非显示类业务是未来公司优化产品结构、营收增长和战略发展的重点。2023年为人工智能（AI）元年，未来随着大数据、物联网、云计算和人工智能等信息技术高速发展，晶圆将逐步从硅延伸到三五族化合物，且在后摩尔时代，先进封装技术将成为超越摩尔定律的重要决胜点。公司将在已有技术的基础上继续深耕，布局非显示类业务后段制程，持续延伸技术产品线，在新材料等领域不断发力，向价值链高端拓展，积极扩充公司业务版图。

三五族化合物被认为是当今电子产业发展的新动力，但其制作的晶圆材质特殊易碎，成本高昂，且应用产品设计多样，生产良率的提高一直为目前的技术痛点。后续，公司将持续精进三五族化合物晶圆的研究，提高技术水平，突破技术瓶颈，克服易碎性等先天限制，以应对新型终端产品的差异化需求。同时，公司将结合目前在凸块制造和覆晶封装等先进封装技术上累积的丰富经验，拓展DPS封装技术的相关制程，满足市场对于更小尺寸和更高集成度的需求。在电源管理、射频前端模块的应用，持续与客户进行深度合作，提供整套封装测试的解决方案，增强公司的技术领先优势，并拓宽服务领域至如高性能计算、数据中心、自动驾驶等尖端市场，争取在国际竞争中占据有利地位。

未来，公司将持续以客户与市场为导向，始终秉持携手共创的精神，充分发挥合肥市产业集群优势，不断提高关键核心技术攻关能力，为我国集成电路产业链高速发展蓄势赋能。

**2、力稳品质，降本提效**

在集成电路行业这片广阔的科技海洋中，品质的稳定是破浪前行的关键。公司将风险思维及过程管理模式贯穿于研发、制造、检测的全流程，透过产品质量先期策划及生产件批准流程，严格把控产品质量形成的各阶段，以确保每一件产品都能达到最高标准，满足客户的需求。

公司严格按照国际、国内相关法律法规、体系及技术标准要求，倾力建置并实施一套完善的品质管理体系，包含了IATF16949汽车行业质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系等一系列国际体系认证。

公司采用先进的制程技术，通过精准的光刻、高均匀性涂布等手段，确保半导体制造过程中的工艺精度和稳定性。同时积极引进自动化、智能化设备，减少人为因素影响，并组建自动化设备改造团队，将旧有设备进行提升,提高设备使用效率。从预算控制、成本分析、系统优化、资源整合等方面认真梳理，运用精益管理方法，落实降本增效的重要措施，在充分保证提供产品和服务质量的前提下，形成“降低风险、持续改善、提升品质、降本提效”的正向循环。

**3、积极推进募投项目建设，缩短产能爬坡期实现快速放量**

2023年度，公司积极推进“颀中先进封装测试生产基地项目”和“颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目”，其中“颀中先进封装测试生产基地项目”已于2023年8月完成建设，2023年9月开始进机，2023年第四季度进行客户的认证并于2024年第一季度开始量产。

2024年度，“颀中先进封装测试生产基地项目”以显示驱动芯片12吋晶圆的封装测试业务为主，公司将结合当地上游晶圆厂和下游面板厂的产业链完整度等情况，积极推展客户新厂验证工作，并通过加强新进员工的训练、使用数字化管理等方式，有效缩短产能爬坡期，确保产品品质的一致性与稳定性，把握终端市场复苏周期，将市场需求加快转化为收入。同时，公司管理层将精准施策，优化资源配置，将合肥及苏州的人员、设备和生产技术等有效整合，实现优势互补，两厂协作并进，最大化发挥经营效益。

公司将持续加强募投项目管理，紧抓行业及技术发展趋势，充分调配内部各项资源，为募投项目储备人才，加快募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目如期达产并实现预期效益，以提升公司盈利水平。

**4、外延发展，布局产业链**

在自身不断夯实主营业务的同时，公司将积极探索通过并购整合适合的标的，从技术互补、规模扩张或市场拓展等方面来提升上市公司的综合竞争力，在充分考量业务布局、协同效应、创新性及独特性的前提下，重点关注集成电路产业链上增长潜力大，技术门槛高的企业。公司将对并购标的进行充分、详尽的尽职调查，评估目标公司的风险和潜在收益，确保并购行为符合公司的发展战略，同时，公司将严格遵守信息披露相关规定，确认实施过程中真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，保障广大投资者知情权益。

**二、以技术创新驱动发展，持续研发投入，强化竞争力**

**1、持续加大研发投入，扎实推进知识产权孵化**

公司采用自主研发模式，以市场和客户为导向，坚持突破创新，不断发展先进封测技术，并设立专业的研发组织及制定完善的研发管理制度。公司技术研发中心负责统筹规划先进封测及相关技术的发展与落实，并拥有一支经验丰富、技术领先的研发团队作为保持技术优势的中坚力量，在新型凸块制造工艺以及封装测试工艺开发的同时，也可快速将研发成果转化为实际生产应用，使得相关技术可在较短时间内形成竞争力。

2023年度，公司研发投入10,629.43万元，较上年同期增长6.39%，且截至2023年末，公司研发人员数量增至225人，较上年同期增长10.29%，研发人员数量占公司比例为15.27%。同时，2023年公司获得授权发明专利11项（中国8项，国际3项）、授权实用新型专利10项，包括晶圆切割方法及晶圆切割装置、用于芯片封装的气动式反应液搅拌装置、晶圆托盘及晶圆片溅渡设备、芯片压接头真空孔清洁装置、涂胶装置及光阻涂布设备、倒装芯片与覆晶封装结构等，且前述部分专利已投入生产应用。

2024年度，公司将聚焦于倒装芯片封装、多层堆叠封装及新材料应用等的先进封装技术领域上，顺应行业发展趋势及新技术的迭代升级，从AMOLED、Micro Oled到新能源车、5G、Wifi7连接等新型应用选定关键立基点，锚定目标聚力前行，推进新研发项目的开展，促进原创性、颠覆性的科研成果，为发展新质生产力持续赋能，夯实公司高质量发展的“硬实力”。

**2、重视人才队伍建设，提升激励水平，吸引并培育高素质人才**

公司始终坚持“人才优先”的经营方针，构建全面系统的人才培训体系，通过定期培训、学术研讨、对外交流、导师带徒等途径，提升员工的业务能力与整体素质。同时，公司还将优化人才激励机制，充分调动员工的工作积极性，在鼓励员工个性化、差异化发展的同时，培养团队意识，增强合作精神。另外，公司持续深化校企科研合作，持续引进优秀的研发人才，不断优化人才体系建设，增强公司的竞争实力。

除了发现和培养公司内部后备人才外，公司对外也积极延揽行业内专业优秀人才。因此，为提供员工市场化的薪酬条件及畅通的晋升管道，公司依经营理念和管理模式并遵照国家有关劳动人事管理政策和公司内部其他相关制度，制定了相应的薪酬管理制度，明确建立与市场接轨并合理保障员工权益的薪酬体系，促使形成激发员工积极性，形成留任和吸引人才的机制，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

为提升公司经营团队及核心员工的忠诚度与稳定度，促进员工创新与发展,吸引并留任优秀人才，同时提升公司长期经营实力与竞争力，激励员工的积极性,公司拟利用股权激励工具，建立长期有效的激励机制。2024年，公司将继续加强人才发展战略，不断优化人才结构，合理使用激励措施，积极引进、培养和留住优秀人才。2024年3月13日，公司公告了《2024年限制性股票激励计划（草案）》，对公司259名员工开展股权激励，构建核心员工与企业风险共担、利益共享的长效机制，为公司长远发展注入持久的动力。未来，公司将严格按照股权激励计划要求实施考核，并继续贯彻长效激励的理念，开展连续性的股权激励计划，有效地将核心团队个人利益与公司长远利益结合在一起，激发员工与企业共进退的内生动力。

**三、重视投资者回报，共享公司发展成果**

公司坚持稳健、可持续的分红策略，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，结合实际及未来规划，制定合理的利润分配方案。公司已在《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定了利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序、机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。2023年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），合计派发现金红利118,903,728.80元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.99%。

2024年，公司将更加注重投资者回报，统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索更加有效的方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红方案，打造可持续的股东价值回报机制。

**四、完善公司治理、保持规范运作、推动高质量发展**

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，形成了由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的健全的公司治理结构。2024年，公司将不断完善治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平，通过打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来合规运营，保障投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。具体措施如下：

**1、规范三会运作，持续完善公司治理结构**

公司严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断优化、完善法人治理结构，及时对治理规则中的有关条款进行修订及完善，建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》等制度，并设置战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会等董事会下属专门委员会。公司充分尊重和发挥监事会、独立董事和董事会专门委员会的作用，坚持合规、有效管理。未来，公司将持续安排董监高参加专业机构和公司内部专业人员的培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习证券市场相关法律法规、理解监管动态，培养自身自律和合规意识，保障投资者权益，推动公司持续规范运作。

**2、加强合规管理，深化内部审计工作**

公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，确保法人治理结构的有效运行，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新发布的相关规则，结合公司实际情况，完成了《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《信息披露管理办法》《对外投资管理制度》《投资者关系管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等多项制度的修订工作，为企业经营管理的合规有效提供了保障，为公司高质量发展保驾护航。

未来，公司将在现有公司治理水平上不断完善，采取适当措施确保公司合规运作，包含加强对各子公司在业务发展、资源整合、要素共享等方面的统筹，发挥战略协同优势；加强质量管理，进一步完善质量管理体系，并加强安全管理，持续推进安全标准化体系的建设，严格执行各种安全生产规章制度；持续优化现有业务流程，并梳理新业务管理流程，借助信息化工具实现高效管理目标，全面有效地控制公司经营和管理风险。

同时，公司将持续深化落实内部审计工作，董事会办公室、财务部、会计部、内审部等相关部门协同推动风险防控措施的执行，重点开展内部专项审计，确保审计结果的持续跟踪与有效反馈，以高质量内部审计助力公司合规运行，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

**五、提高信息披露水平，加强投资者沟通**

公司高度重视信息披露工作的规范化，严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理办法》等规定，全面规范信息披露事务，提高信息披露工作水平，增强公司透明度，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。未来，公司将继续严谨、合规、高质量开展信息披露工作，切实维护好投资者获取信息的平等性，致力于保障投资者的知情权，为了不断提高信息披露质量，将积极参与监管部门组织的信息披露专项培训，加强对内幕信息等重点事项的管理，防范信息披露风险。

公司建立了较为规范的投资者关系工作体系，设立了投资者关系专用邮箱与投资者沟通热线，并于公司官网设置“投资者关系”频道，其中下设了“公司治理”、“财务摘要”、“信息公告”、“投资者联系”多个分栏，使得投资者关系工作更高效，更容易上传下达，在符合监管规定的基础上，不断探索创新，以更好的达成投资者关系工作的效果。

2024年，公司将进一步强化信息披露的透明度，为股东提供准确的投资决策依据，不断完善投资者意见传递渠道，详细了解投资者的真实诉求，并通过各种渠道有针对性地回应，不断提升公司信息披露质量，树立市场信心。具体措施如下：

1、在定期报告披露后，公司将积极邀请投资机构、分析师及有意向的中小投资者，参与公司业绩交流会或者线上线下投资者调研活动，详细解答投资者疑问。2024年，公司计划开展不少于3次（含）的公开业绩说明会，不定期接受线上/现场调研，广泛邀请投资者特别是中小投资者、分析师等参加，通过电话、视频、图文、文字回复等多种方式积极与投资者交流互动，全方位传递公司价值，降低投资者门槛，保障各类投资者的各项权益。

2、公司募投项目“颀中先进封装测试生产基地项目”投入生产后，将邀请相关投资者参观公司，由专人陪同并详细介绍，提供更生动、直观的机会了解公司的发展历程，传递公司的经营理念。

3、公司将提高上证e互动平台及投资者关系邮箱的回复率，设置投资者专线电话实时转接服务，积极接听投资者热线，确保投资者问询渠道畅通无阻。

**六、强化“关键少数”责任**

公司通过多维度方式重点加强关键少数——控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的相应职责，以切实的行动提升治理水平。公司在上市过程中，“关键少数”人员按照法律法规的相关要求就股份限售及稳定股价等方面进行了承诺。公司上市后，除组织“关键少数”人员参加资本市场监管部门组织的法定培训，同时将充分借助上海证券交易所浦江大讲堂、上市公司协会培训平台等监管培训资源，组织“关键少数”及公司经营管理层进行线上、线下的培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。同时，公司于2024年限制性股票激励计划中也设置了净利润率、每股收益的考核指标，在注重经营业绩增长外，也要求公司保持良好的股东回报能力与优秀的经营效率，重视投资者利益，落实 “提质增效重回报”行动方案。

**七、其他**

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，专注主营业务，提升公司的核心竞争力、努力通过良好的业绩表现，规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

本行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，所涉及的公司发展战略、发展规划等内容系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

合肥颀中科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日